



平成27年6月25日

各位

会社名 住友精密工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 三木 伸一
(コード番号 6355 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 中本 圭一
(TEL:06-6482-8811)

子会社による新会社設立および事業譲受けに関するお知らせ

当社は、平成27年6月25日開催の取締役会において、当社子会社であるSPPテクノロジーズ株式会社(以下SPT株)が米国に100%出資の新会社SPT USA, Inc. (以下SPT USA) を設立してSPTS Technologies UK Limited (以下SPTS) より事業を一部譲り受けることを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 事業譲受けの理由

当社は、平成23年7月にSPTS経営陣の提案に応じる形で、同社経営陣およびBridgepointへSPTS株式を譲渡しましたが、その後もSPT株を合併で設立する等、SPTSとの友好関係を維持してきました。一方、SPTSは、Advanced Packaging、MEMS、RF、パワーデバイスの最終製品市場向けに、その技術および経営資源を枚葉処理のEtch、CVD、PVD製品群へ集中する戦略を決定し、この結果、SPTSからThermal Products事業(以下TP事業)売却の提案がSPTにありました。

このTP事業は米国シリコンバレーに拠点を持つ、半導体製造工程用の熱処理炉関連ビジネスで、現在は新作装置、Remanufacturing装置、スペアパーツの販売や、修理メンテナンス、アップグレード等のサービス提供からなり、併せて関連製品の開発も行っております。またこのTP事業は、これまで安定した売り上げを計上しており、今後もこの傾向が続くものと予想されています。

当社グループといたしましては、本事業の変動リスクは限定的であり、他方、SPT株を中心に行っておりますマイクロテクノロジー事業規模の拡大並びに海外拠点の獲得が図れること、既存製品・技術とのシナジー効果が期待できること、SPTSとの友好関係維持に資すること等に鑑み、SPT株により新会社SPT USAを設立の上、本件TP事業を譲り受けることといたしました。

2. 設立する新会社の概要(予定)

(1) 名 称	SPT USA, Inc.
(2) 所 在 地	米国 1150 Ringwood Court, San Jose, CA 95131
(3) 代表者の役職・氏名	President 荻野誠一
(4) 事 業 内 容	半導体製造用熱処理装置等の製造・販売・サービス提供
(5) 設 立 年 月 日	平成27年6月
(6) 大株主および持株比率	SPT株 100%

3. 新会社を設立する子会社の概要

(1) 名 称	SPP テクノロジーズ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町 1-3-2 (経団連会館 15 階)	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 速水利泰	
(4) 事 業 内 容	半導体関連製造用プロセス装置 (エッチング、成膜装置) の開発・製造・販売	
(5) 資 本 金	495 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 23 年 10 月 11 日	
(7) 純 資 産	1,144 百万円	
(8) 総 資 産	2,429 百万円	
(9) 大株主および持株比率	当社 95% / SPTS 5%	
(10) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式 95%を所有しています。
	人的関係	当社の取締役 1 名が当該会社の代表取締役社長を兼任しています。
	取引関係	当社は半導体関連製造用プロセス装置及びその部品に関して、当該会社から調達し、販売をしております。

4. 事業譲渡会社の概要

(1) 名 称	SPTS Technologies UK Limited	
(2) 所 在 地	英国 Ringland Way, Newport, Gwent, Wales NP18 2TA	
(3) 代表者の役職・氏名	President, Kevin Crofton	
(4) 事 業 内 容	各子会社を通じた半導体関連製造用プロセス装置 (エッチング、成膜装置) の開発・製造・販売	
(5) 資 本 金	28,500,000 ポンド	
(6) 設 立 年 月 日	平成 21 年 10 月 12 日	
(7) 大株主および持株比率	Orbotech Limited 100%	
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社は半導体関連製造用プロセス装置及びその部品の一部に関し、SPT(株)を通して当該会社より調達をしております。

5. 事業譲受けの概要

(1) 譲受事業の内容

事業譲渡会社が行っている半導体関連製造用熱処理装置等の製造・販売・サービス提供

(2) 譲受事業の経営成績

	2014年12月期
売上高	26,169千ドル

※譲受事業の売上総利益、営業利益、経常利益については算出しておりません。

(3) 譲受事業の資産、負債の項目及び金額

主要な譲受資産：棚卸資産・無形固定資産

※その他譲受資産の項目・金額につきましては、事業譲渡会社に対する守秘義務により非開示とさせていただきます。

(4) 譲受価額及び決済方法

譲受価額：約22百万USドル

決済方法：現金による決済

6. 日程

取締役会決議日	平成27年6月25日
事業譲渡契約締結日	平成27年6月25日
事業譲受日	平成27年6月30日（予定）

7. 今後の見通し

本件による平成28年3月期の業績に与える影響につきましては、精査の上、改めてお知らせします。

以上